

2024第23届西部光电博览会成都全球芯片半导体展设计搭建 展览展台搭建

产品名称	2024第23届西部光电博览会成都全球芯片半导体展设计搭建 展览展台搭建
公司名称	上海瑞秀会展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:瑞秀会展 服务场景:展会展台展览搭建 发货地:成都
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢1928室
联系电话	18717735710 18717735710

产品详情

【本届展会】：

2024第23届西部成都全球芯片与半导体产业博览会

正式展期：2024年4月24日-26日

展览地点：成都世纪城新国际会展中心举行

同期配套活动：

2024第二届西部半导体产业创新与发展高峰论坛（CWGCE2024主论坛）

2024成渝电子信息产业高峰论坛

2024西部电子智造与机器人创新发展论坛

同期展会：

2024第23届芯片与半导体产业博览会

2024第23届西部国际信息通信博览会暨数字智能展

2024西部国际广播电视信息网络博览会

大会主题：

西部“芯”机遇 共创“芯”未来

随着数字中国和智慧社会战略目标的加快推进，国家促进集成电路产业政策环境不断完善，以协同创新、开放合作、智能应用、

深度融合为特征的中国集成电路产业正呈现出全新格局，产业平稳快速增长，技术创新持续活跃，兼并重组不断深入，产融结合日益密切，

市场需求广泛拓展，国际联动发展显著。国家集成电路产业投资基金撬动作用显现，地方性基金相继设立，有效带动一批重点项目投资。

回顾“十三五”，全球集成电路产业进入深度调整与转折期，这是中国集成电路产业实现“华丽转身”的重要机遇期。

【展览范围】：

- 1.半导体设计、封测、制造产厂商；
- 2.原材料：硅晶圆、硅晶片、光刻胶、光掩膜版、电子气体及特种化学气体、CMP抛光材料、光阻材料、湿电子化学品、溅射靶材、封测材料；
- 3.生产设备：单晶炉、氧化炉、扩散设备、离子注入设备、PVD、CVD、光刻机、蚀刻机、抛光机、倒角机、涂胶/显影机等；
- 4.封装工艺及设备：减薄机、划片机、贴片机、焊线机、塑封机、打弯设备、分选机、测试机、机器人自动化、机器视觉、其他材料和电子专用设备；
- 5.测试与封装配套产品：探针卡、引线键合、烧焊测试、自动化测试、激光切割及其它、研磨液，划片液、封片膜(胶)高温胶带、层压基板等；
- 6.5G通信：方案、设备、元器件、新材料、应用；
- 7.二手设备专区；
- 8.半导体分立器件产品与应用技术等；
- 9.半导体光电器件；
- 10.IC产品与应用技术、IC测试方法与测试仪器、IC设计与设计工具、IC制造与封装。

展区设置：

智能电子与电子智造展

信息通信与数字智能展

【参展费用】：

请来电咨询了解详细需要及参展情况，展会展台搭建展位预定中！